

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2026-022

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于境外上市股份（H 股）公开发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 32.30 港元（不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565% 香港联交所交易费及 0.00015% 香港会计及财务汇报局交易征费）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 7 月 10 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日